(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-313097 (P2000-313097A)

(43)公開日 平成12年11月14日(2000.11.14)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		~	テーマコード(参考)
B 3 2 B	31/04		B 3 2 B	31/04		2H025
	27/00			27/00	Z	4F100
H05K	3/28		H05K	3/28	F	5 E 3 1 4
# G03F	7/004	5 1 2	G03F	7/004	5 1 2	
	7/16			7/16		
			審査請	求 未請求	請求項の数3	OL (全 4 頁)

(21)出願番号 特

特願平11-124548

(22)出願日

平成11年4月30日(1999.4.30)

(71)出願人 000004455

日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72)発明者 岡田 直人

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式

会社筑波開発研究所内

(74)代理人 100071559

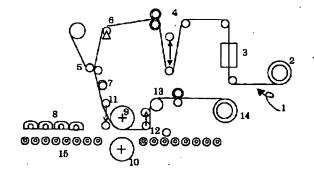
弁理士 若林 邦彦

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ラミネート方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】基板の先端部、後端部を除いた基板面内の必要 な部分に転写層をむら、しわなく正確に、かつ高速にラ ミネートし、生産効率を向上させ、基板に異物の発生要 因となる転写層などのはみ出しのない基板を得ること。 【解決手段】長尺積層フィルムを連続的に送り出す工 程、連続して供給される基板と基板の間隔と基板端部の 転写不要部分に対応した位置をカバーフィルム上から活 性光線を照射する工程、カバーフィルムを連続的に剥離 する工程、連続して供給される所定の間隔を空けて配置 された基板に転写層を転写する際、転写不要部である基 板前後端部に活性光線照射部が来るように位置合わせを 行い順次ラミネートする工程、ベースフィルムを連続的 に剥離する工程を備え、連続供給される所定の間隔を空 けて配置された基板に対し、ベースフィルム上に感光性 樹脂層及びカバーフィルムが順に形成された長尺積層フ ィルムから感光性樹脂層を連続的にラミネートする。



09/22/2003, EAST Version: 1.04.0000

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】連続して供給される所定の間隔を空けて配置された被転写基板に対し、光透過性ベースフィルム上に感光性樹脂層及び光透過性カバーフィルムが順に形成された長尺積層フィルムから感光性樹脂層を連続的に転写し、ベースフィルムを剥離するラミネート方法であって、ラミネート前に被転写基板上の転写不要部に対応する感光性樹脂層に対して、ベースフィルムまたはカバーフィルム側から活性光線を照射し、カバーフィルムを剥離し、感光性樹脂層を基板に転写後、ベースフィルムを10感光性樹脂転写不要部とともに被転写基板より剥離することを特徴とするラミネート方法。

1

【請求項2】請求項1項に記載したラミネート方法であって、長尺積層フィルムの感光性樹脂層からカバーフィルム剥離する際、ラミネート動作停止に合わせてカバーフィルム剥離位置が常に活性光線照射部分にあるようにしたラミネート方法。

【請求項3】請求項1項に記載したラミネート方法であって、活性光線照射部が被転写基板のラミネート進行方向前後端部の両辺に掛かるように配置され、剥離の起点 20 または終点となるようにしたラミネート方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ベースフィルム上 に感光性樹脂層及びカバーフィルムが順に形成された長 尺積層フィルムから感光性樹脂層を基板に連続的に転写 しラミネートする方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、基材フィルム上に形成された転写 層を基板上にラミネートするために種々の方法が提案さ 30 れている。例えば特開平3-205134号公報には、 初めに、ラミネートする積層フィルムの先端側を積層フ ィルムの供給方向に対して垂直に切断し、この積層フィ ルムの先端部を基板搬方向の先端部に圧着した後、ラミ ネートロールにて順次、積層フィルムを供給しながら基 板にラミネートする、すなわち基板の後端に対し、基板 の長さに合わせて積層フィルムの後端を位置決めし切断 した後、積層フィルムの後端を支持しながらラミネート する方法が開示されている。この方法により積層フィル ムをラミネートすると、基板上に積層フィルムカット部 40 分からの転写層、中間層等が熱流動により流れ出し基板 上に汚れとして付着する問題点がある。また、基板の先 端と後端に合わせて積層フィルムをカットし、張り合わ せるため積層フィルムのテンション変動が発生し、積層 フィルムの膜厚むらやたわみによりしわなどが発生す る。さらに積層フィルムの先端を仮付け、フィルムのカ ットなどにより、ラミネート動作の途中で一時停止また は瞬間停止などが入り、ラミネートの高速化が難しい。 さらに、感光性樹脂の特性によっては、カバーフィルム の剥離工程でこの停止動作により、剥離位置の感光性樹 50

脂層上に筋状の跡が発生したり、感光性樹脂層自体がカ バーフィルム側に剥ぎ取られたりする不良が発生する。 【0003】その他の方法として、特開平5-3380 40号公報に示された方法がある。まずカバーフィルム を剥離した後、基板の先端部、後端部において転写不要 部と転写が必要な転写層の界面にカッターで切れ目を入 れておき、これを基板に対し、位置合わせてラミネート する。このとき、転写の不要な部分である基板先端、後 端部と基板と基板の間隔では、ラミネートローラを開閉 し、圧着動作を行わない。このラミネート動作を連続的 に繰り返し基板に転写層をラミネートした後、基材フィ ルムを連続的に基板より剥離する。このとき基材フィル ムの剥離は、切れ目の入った先端、後端部から必要な部 分の転写層のみを残して行われる。また前もって基板間 隔の部分の感光層を取り除いておくことも可能である方 法が開示されている。

【0004】この方法は、ラミネートが約0.5~0. 8m/分の低速度運転の場合において、ロールの開閉動 作が基板と基板の間に対して追従するため効果がある。 しかし転写層が1m/分以上の高速ラミネート運転の場 合は、積層フィルムのテンション変動が頻繁に起こり、 積層フィルムの位置ずれによりラミネートの位置精度が 悪くなり基板の先端、後端部の設定位置をはずれてラミ ネートされる。この結果、基材フィルム剥離の際切れ目 のが基板の端部にかかり剥離面の転写層が剥離し難くな ったり、圧着の必要な基板面の転写層が剥がれたりす る。また、ラミネート時の積層フィルムテンションが圧 着ロールの開閉制御時に変動するため、圧着された基板 の転写層面にしわ、膜厚むらを発生させるという問題点 が起きやすい。更に、カット目を入れた感光性樹脂層の 分断面が、ラミネートロールで熱の影響を受けて融着し てしまうため、ベースフィルム剥離の際に充分な剥離界 面が得られない、剥離の起点および終点が惚けてしまい 貼付け端面の直線性が得られないなどの問題点が発生す る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような問題点を改善し、基板の先端部、後端部を除いた基板面内の必要な部分に転写層をむら、しわなく正確に、かつ高速にラミネートし、生産効率を向上させるとともに、基板に異物の発生要因となる転写層などのはみ出しのない基板を得ることができるラミネート方法を提供するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明のラミネート方法は、連続して供給される所定の間隔を空けて配置された基板に対し、ベースフィルム上に感光性樹脂層及びカバーフィルムが順に形成された長尺積層フィルムから感光性樹脂層を連続的にラミネートする方法であって、長尺積層フィルムを連続的に送り出す工程、連続して供給さ

3

れる基板と基板の間隔と基板端部の転写不要部分に対応した位置をカバーフィルム上から活性光線を照射する工程、カバーフィルムを連続的に剥離する工程、連続して供給される所定の間隔を空けて配置された基板に転写層を転写する際、転写不要部である基板前後端部に活性光線照射部が来るように位置合わせを行い順次ラミネートする工程、ベースフィルムを連続的に剥離する工程を備えることを特徴とする。さらに、長尺積層フィルムのラミネートが一旦停止するような、カバーフィルム剥離工程において、カバーフィルム剥離が一旦停止する場合、カバーフィルム剥離の停止位置を活性光線照射部内に位置させるカバーフィルム剥離工程を備えることを特徴とする。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明の一実施例を以下図面に基づいて説明する。図1は、転写層であるドライフィルム感光性樹脂層のラミネート法を実施するためのラミネート装置である。このラミネート装置は、基板搬送部、基板予熱部、ラミネート部、フィルム基板間処理部、フィルム供給部、フィルムアキュムレート部、ベースフィルム連続剥離部、カバーフィルム連続剥離部より構成される。

【0008】一連のラミネートの工程を、図1を参照し ながら説明する。ラミネートするフィルムは、ベースフ ィルム上に転写層及びカバーフィルムが順に形成された 長尺積層フィルム1であり、フィルム供給部2より巻き 出され、カバーフィルム付きの状態で基板間処理部3に 導かれる。基板間処理部の詳細を図2に示した。基板間 処理部は、機能的に2つ部分から構成される。1つは、 基板に対しラミネートする際に感光性樹脂層が分断され 30 た端面を平滑化する部分。もう1つは、基板に転写され る感光性樹脂層が予め決められた基板端部より内側に転 写されるため、基板前後両端部に感光性樹脂層が転写さ れるのを防ぐ領域および基板と基板の間隔でラミネート ローラなどに感光性樹脂が付着するのを防ぐ領域におい て、紫外線などの活性光線により感光性樹脂層を露光す る部分の2つから構成されている。感光性樹脂層の端面 を分断し、平滑化する部分では加熱バーaが基板の間隔 に対応して配置されており、この間隔は、連続投入され た基板と基板の間隔と基板端部のラミネートされない部 40 分の合計の幅に一致する。また、加熱バーは光遮蔽機能 を同時に備えており、バー押圧時に露光することで転写 を必要としない感光性樹脂層に選択的に活性光線を露光 ランプbより照射することができる。

【0009】上記基板間処理工程を通過したフィルム ラミは、フィルムアキュムレート部4にて基板1枚分のラミ (0 ネートに必要な長さを貯えられる。先に説明したフィルム基板間処理は、フィルムの流れを一時的に止めて処理 球るため、投入されてきた基板に対し常に連続的にフィ むらルムをラミネートするためには、予め基板1枚分を先に 50 る。

4

フィルム基板間処理しておき、さらに基板をラミネート している時間内に、次に投入される基板のフィルム基板 間処理を前倒しで行うことで対応できる。上記アキュム レート部を通過後、カバー巻き取り機にて基板1枚分の 長さのカバーフィルム f をカバー剥離ガイド5から巻き 取る。先に述べたフィルム基板間処理で、フィルムの流 れが一時停止した場合、カバーフィルムを感光性樹脂層 から剥離する位置が必ずフィルム基板間処理した領域部 cのフィルム流れ方向中心に来るように、カバー剥離ガ イドの位置を調整する(図3を参照)。基板間処理部 は、活性光線の照射により感光性樹脂層表面のタック性 が低下している。この結果、カバーフィルム剥離停止時 に発生する感光性樹脂層上の筋や、カバーフィルム剥離 時に感光性樹脂がカバーフィルム側に引き剥がされるこ とがない。カバー剥離の後、ラミネートロール9、10 にフィルムが送られる。この時、フィルムの張力は張力 検出器6により検出された数値をもとに張力調整ロール 7によってロールの上下動や、ラミネートの作動、停止 状態に関わらず常に一定になるように調整される。一 方、感光性樹脂層が転写される基板は、基板予熱部8に 送られ予熱ヒータ(遠赤外ヒータなど)により所望の温 度(感光性樹脂層の種類によって異なるが一般的に40 ~100℃)に加熱される。加熱により基板は、上下面 に対して均一に加熱されラミネート部に送られる。基板 およびフィルムは、常に位置制御センサなどにより位置 制御されており、図4に示すように基板間処理されたフ ィルムの部分でに、基板と基板の間隔および基板端面部 が一致するようにラミネートされる。このように活性光 線照射部cが被転写基板のラミネート進行方向前後端部 の両辺に掛かり、活性光線照射部剥離の起点または終点

【0010】ラミネートは一対のラミネートロール9、10により行う。15は、搬送ロールである。ラミネート後、ベースフィルムは剥離ガイド12を介して基板より剥離される。予め、活性光線によって露光された基板間処理部の感光性樹脂層は基板より引き剥がされ、ベースフィルムとともに巻き取られる。この時、基板の温度は、ロール温度にほぼ近い状態でベースフィルムが基板より剥離される。ロール温度に近ければ近いほど剥離性が向上する。例えば特開平8-211222号公報に記載されるような構造の感光性樹脂層フィルムであれば更に連続ベースフィルム剥離には望ましい。

【0011】以上のラミネート法は、プリント基板、カラーフィルタを初めとしたドライフィルム等の転写層のラミネートを行う分野に適用することが可能である。 【0012】

【発明の効果】本発明のラミネート法により、基板上に 感光性樹脂層等の転写層を位置精度良く、転写層の膜厚 むらなくかつ連続的に高速でラミネートすることができ る

となる。

6

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明のラミネート装置を説明する側面図。
- 【図2】本発明のラミネート装置で使用される基板間処理部の詳細を示す側面図。

5

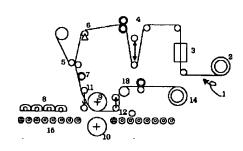
- 【図3】カバーフィルム剥離とフィルム基板間処理部の位置関係を示す断面図。
- 【図4】基板に転写される感光性樹脂層と剥離されるベースフィルムの状態を示す断面図。
- 【図5】ベースフィルム剥離ガイドによる剥離の状態を示す断面図。

【符号の説明】

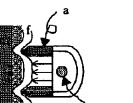
- 1. 長尺積層フィルム
- 2. フィルム巻き出し部

- 3. 基板間処理部
- 4. アキュムレート部
- 5. カバーフィルム剥離ガイド
- 6. フィルム張力検知器
- 7. フィルム張力調整器
- 8. 基板予熱部
- 9. ラミネートロール (上)
- 10. ラミネートロール(下)
- 11. 基板待機ガイドロール
- 10 12. ベースフィルム剥離ガイドロール
 - 13. 巻き上げガイドロール
 - 14. ベースフィルム巻き取り部
 - 15. 搬送ローラ

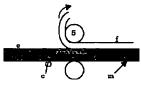
【図1】



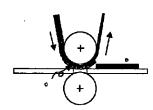




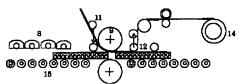
【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA17 AA18 AB11 AC01

ADO1 EA08 FA01

4F100 AK01A AK01B AK01C ASOOC AT00A BA03 BA07 BA10A BA10C GB90 JB14B JL02 JN01A JN01C

5E314 AA27 BB02 BB11 CC15 DD01 DD05 FF01 GG24